

マルチ真空プロセス装置

センターチャンバーの周辺に

ロードロック室を含めて全6室を搭載可能な

クラスター型複合プロセス装置を開発

【特徴】

- センターチャンバーと各室間にゲートバルブを配置しコンタミを防止
- ゲートバルブをセンターチャンバー内に組み込み、省スペース化を実現
- メインポンプ(ターボ分子ポンプ)をチャンバー上部に取り付け高メンテナンス性を実現
- 独自開発の真空搬送ロボットを搭載
- 各室独立の真空排気系を装備(但し、センターチャンバーとロードロック室は共用)
- $\pm 3\%$ の膜厚分布のスパッタ成膜ユニットを搭載
- 最高1000℃まで昇温可能なランプアニールユニットを搭載
- $\phi 300\text{Si}$ ウエハーを13枚搭載可能なカセットロードロック室を装備

